

## 2019 年材料科学与半导体器件国际会议 (MSSD2019) 征稿通知

### 一、大会简介

2019 年材料科学与半导体器件国际会议 (MSSD2019) 将于 2019 年 11 月 15 日至 17 日在中国深圳隆重举行。会议主要围绕材料科学与半导体器件等研究领域展开讨论。会议旨在为从事材料科学与半导体器件研究的专家学者、工程技术人员、技术研发人员提供一个共享科研成果和前沿技术,了解学术发展趋势,拓宽研究思路,加强学术研究和探讨,促进学术成果产业化合作的平台。大会诚邀国内外高校、科研机构专家、学者,企业界人士及其他相关人员参会交流。

### 二、会议议程

初步拟定为如下会议日程:

2019 年 11 月 15 日 13:00-17:00	报名注册
2019 年 11 月 16 日 09:00-12:00	主题报告
2019 年 11 月 16 日 14:00-17:30	口头报告
2019 年 11 月 17 日 09:00-18:00	学术考察

### 三、征稿内容

本次会议主要采用会前线上征稿的形式。

#### (一) EI 会议征稿

本会议所有的投稿都必须经过 2-3 位组委会专家审稿, 经过严格的审稿之后, 最终所有录用的论文将由 EI 列表期刊 *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)* (ISSN: 1757-8981) 出版, 见刊后将被 EI、Scopus 和 CPCI 检索。

征稿主题包括但不限于以下内容:

#### 1. 材料科学

##### (1) 材料科学基础:

- ① 计算材料科学;
- ② 材料力学;
- ③ 材料物理化学;
- ④ 材料的质地、结构、缺陷与性能;

##### (2) 材料科学与工程:

- ① 半导体与功能材料;
- ② 超导材料;
- ③ 电子和磁性材料;
- ④ 结构材料;

##### (3) 材料技术与应用:

- ① 材料的设计、建模和仿真;
- ② 材料加工技术; 材料测试与分析;
- ③ 材料失效与保护;
- ④ 创新材料; 新型离子交换材料;
- ⑤ 航空航天材料技术。

## 2. 半导体器件

- (1) 半导体材料和应用/半导体加工；
- (2) 新兴半导体技术；
- (3) 新型半导体器件及其应用；
- (4) 半导体物理学；
- (5) 器件设计与制造；
- (6) 设备性能和可靠性；
- (7) 铁磁性/磁性半导体；
- (8) 化合物半导体；
- (9) 有机半导体；
- (10) 半导体探测器。

## 3. 其他主题

### (二) SCI 期刊征稿

推荐 20 篇优秀论文到 SCI 期刊，录满截止，欢迎投稿！

(备注：仅可邮箱 [service@keoaeic.org](mailto:service@keoaeic.org) 投稿，请标注“SCI 稿件-ICMSSD”)

## 四、投稿形式

第一轮截稿日期：2019 年 9 月 20 日

第二轮截稿日期：2019 年 11 月 5 日

### (一) EI 会议稿件

登录 2019 年材料科学与半导体器件国际会议“投稿方式”页面（网址：<https://www.keoaeic.org/MSSD2019/submission>），下载文章模板、作者登记表。完成文章排版、表格填写后，文件发送 AEIC 投稿系统或 [ICMSSD@yeah.net](mailto:ICMSSD@yeah.net)。

## （二）SCI 期刊稿件

登录 2019 年材料科学与半导体器件国际会议“投稿方式”页面（网址：<https://www.keoaeic.org/MSSD2019/submission>）下载 SCI 期刊文章模板。进行排版后发送至 [service@keoaeic.org](mailto:service@keoaeic.org)，并标注“SCI 稿件-ICMSSD”。

## 五、参会方式

填写参会回执表（见附件 1），或登录 2019 年材料科学与半导体器件国际会议“中文”页面（网址：<https://www.keoaeic.org/MSSD2019/zhongwen>）下载参会回执表，填写相应信息后发送至 [ICMSSD@yeah.net](mailto:ICMSSD@yeah.net)。

\*注：每篇获得录用的文章，可有 1 名作者免费参会。

## 六、联系方式

会议网站：<https://www.keoaeic.org/MSSD2019>

投稿邮箱：[ICMSSD@yeah.net](mailto:ICMSSD@yeah.net)

投稿/参会/会务：谢老师

手机/微信：86-139 2215 7864

QQ 咨询：1966347161

地址：广东省广州市越秀区中山一路 57 号南方铁道大厦 27 楼

欢迎各院校、学术单位、科研企业结合实际需求，积极参加并发动海内外学术人才参加 2019 年材料科学与半导体器件国际会议。



附件 1



## 2019 年材料科学与半导体器件国际会议 (MSSD2019)

时间: 2019 年 11 月 15-17 日

地点: 中国-深圳

网址: <https://www.keoaeic.org/MSSD2019>

邮箱: ICMSSD@yeah.net

### 参会回执表

基本信息 / Personal Information *			
稿件编号 Manuscript Number:			
姓名 / Name:		性别 / Gender:	
职称 / Title:		职务 / Position:	
国家 / Country:		微信 / WeChat:	
电话 / Phone:		邮箱 / E-mail:	
学校 / University:			
研究领域 / Research Area:			
随行人员 / Retinue:	若有随行人员, 请复制此表并填写完整后返回.		
参会意愿 / Presentation & Preference (可多选 / Multiple Choices) *			
<input type="checkbox"/> 特邀报告 / Keynote Speeches (Upload detailed academic CV) <input type="checkbox"/> 听众 / Listener <input type="checkbox"/> 口头报告 / Oral Presentation <input type="checkbox"/> 墙报展示 / Poster <input type="checkbox"/> 考察活动 / Academic Investigation			
*Final decision will rest with the Committee			
注册费用 /Registration Type & Fee *			
Registration Type	注册费用 (人民币)	Registration Fee (By US Dollar)	
听众 / Listener	1200 元 / 人	150 USD / person	
*已投稿者根据投稿费用缴费即可, 无需另缴参会费; 参加考察活动需另付 300 元			
*非投稿者及其他随行人员如需参会, 须缴纳 1200 元参会费; 参加考察活动需另付 300 元			

酒店预订/Hotel Reservation *			
房间类型/Room Type		房间数量/Room Quantity	
入住日期/Check-in Date		退房日期/Check-out Date	
<p>房间地点: 酒店信息待定, 会前一个月更新, 请留意会议官网最新消息。</p> <p>标准大床房 xx 元/天 (Standard Twin Bed Room: xx USD / night)            标准双床房 xx 元/天 (Standard Double Beds Room: xx USD / night)            * 房间均含网络及早餐. The above room type includes the Internet and breakfasts.            * 请在酒店前台以会议主办方的名义按优惠价入住即可.</p>			
报告题目及摘要 / Title & Abstract *			
报告人 / Author			个人照片
报告题目 / Title			
摘要 / Abstract			

\*Please fill in, save the file and feedback via Email: [ICMSSD@yeah.net](mailto:ICMSSD@yeah.net)

\*Registration fees includes conference brochure, banquet, lunches, gifts, tea break.

\*此表复制有效, 请填写完整后发送至会议秘书处: [ICMSSD@yeah.net](mailto:ICMSSD@yeah.net)

\* 注册缴费、住宿、议程等安排请查看后续会务邮件, 或登陆大会网站:  
<https://www.keoaeic.org/MSSD2019> 关注会议最新动态。